

证券代码: 688362  
债券代码: 118057

证券简称: 甬矽电子  
债券简称: 甬矽转债

公告编号: 2026-004

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- **投资标的名称:** 马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目。
- **投资金额:** 项目投资总额不超过 210,000 万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），约占公司总资产的 13.68%（截至 2025 年 9 月 30 日）。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:** 本次对外投资事项已经甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次对外投资尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审批手续。

### ● 风险提示:

- 1、本次对外投资项目尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审批手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。
- 2、本次对外投资项目风险可控，但上述项目投资建设可能会对公司的现金流造成压力，项目建设周期为 60 个月，公司将统筹资金安排，根据项目进度分批投入资金，确保项目顺利实施。
- 3、本次对外投资项目的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风

险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### (一) 本次交易概况

#### 1、本次交易概况

根据公司战略规划，为进一步完善公司海外战略布局，推动海外业务发展进程，公司拟投资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目，投资总额不超过人民币 210,000 万元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），约占公司总资产的 13.68%（截至 2025 年 9 月 30 日）。

#### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过人民币 210,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司投资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目的议案》。同时董事会授权公司管理层或其授

权人员负责办理与本次对外投资相关的具体事宜，包括但不限于签署与此项投资相关的手续及文件、办理投资项目备案等事宜。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》规定，该事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资项目尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审批手续。

### （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

公司拟投资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目。

### （二）投资标的具体信息

#### 1、投资项目

##### （1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目
项目主要内容	集成电路封装和测试生产基地生产线及配套厂房设施
建设地点	马来西亚槟城
项目总投资金额（万元）	不超过人民币 210,000 万元
上市公司投资金额（万元）	不超过人民币 210,000 万元
项目建设期（月）	60
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

##### （2）各主要投资方出资情况

本项目投资主体为公司在马来西亚设立的子公司，项目总投资金额不超过人民币 210,000 万元，公司将根据项目进度以现金方式分批注资到位。

##### （3）项目目前进展情况

目前，该项目处于前期筹备阶段，暂未办理完成相关审批手续，审批结果存在不确定性。

#### （4）项目市场定位及可行性分析

马来西亚在全球半导体制造特别是封测环节占据重要地位，槟城州作为马来西亚的半导体产业重要基地，已经吸引了众多国际芯片大厂在此布局，形成了良好的产业集群效应。本项目能够借助当地的市场环境和产业基础，进一步扩大公司海外市场规模，提升公司的营收水平，有助于巩固并提升公司的行业地位。经综合分析，该项目具备良好的市场前景与实施可行性，预期将对公司中长期可持续发展产生积极影响。

#### （三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本项目建设内容主要为系统级封装产品等封装产品，下游应用领域包括AIoT、电源模组等。

本次对外投资符合国家产业政策导向及公司整体战略布局，是公司把握行业发展机遇、实现海外产业布局的重要战略举措。项目建成后，一方面将有效补充公司未来业务发展面临的产能缺口，巩固并提升公司在全球集成电路封装和测试业务市场的份额；另一方面将有利于深化公司与海外大客户的战略合作、进一步增强盈利能力、降低运营风险及提高综合竞争力。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资项目尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审批手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

2、本次对外投资项目，风险可控，但上述项目投资建设可能会对公司的现金流造成压力，项目建设周期为 60 个月，公司将统筹资金安排，根据项目进度分

批投入资金，确保项目顺利实施。

3、本次对外投资项目的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年1月13日